

北京耐威科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]146号），以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案实施完毕，公司本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过37,037,428股（含本数）相应调整为不超过55,556,142股（含本数）。

2、公司于2018年6月14日与杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州溯智”）签订了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

3、因杭州溯智放弃认购，本次非公开发行方案的发行对象由三家调整为两家，即发行对象为国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春；本次非公开发行募集资金总额由不超过196,954.40万元调整为不超过160,000.00万元，募集资金项目投入情况作相应调整。

4、根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，公司上述事宜由董事会授权人士进行办理，不需要另行召开董事会及股东大会进行审议。

5、公司正根据有关规定推进本次非公开发行相关事宜，最终的具体发行及募集资金情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已于近日获得证监会的核准批复。

本次非公开发行募集资金总额不超过 196,954.40 万元，其中，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）认购金额不超过人民币 140,000 万元、杭州溯智认购金额不超过 36,954.40 万元、公司控股股东杨云春认购金额不超过 20,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 196,954.40 万元，扣除发行费用后将全部用于 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目和航空电子产品研发及产业化项目。

鉴于融资环境的变化及本次非公开发行的时间需求，经与公司友好协商，杭州溯智决定放弃认购公司本次非公开发行的股票。依据公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司于 2018 年 6 月 14 日与杭州溯智签署了《附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议》。公司董事会拟相应对本次非公开发行股票的数量、发行对象及募集资金金额进行调整。因本次非公开发行对象的变化，结合公司 2017 年年度权益分派对非公开发行股票数量的影响，本次调整的具体情况如下：

一、发行对象

（一）调整前

本次非公开发行对象为国家集成电路基金、杭州溯智、杨云春，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

（二）调整后

本次非公开发行对象为国家集成电路基金、杨云春，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

二、发行数量

（一）调整前

本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过 196,954.40 万元，其中，国家集成电路基金认购金额不超过人民币 140,000 万元、杭州溯智认购金额不超过 36,954.40 万元、杨云春认购金额不超过 20,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发

行认购金额/每股发行价格。在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格及发行数量将作相应调整。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，截至第二届董事会第三十八次会议召开之日，上市公司总股本为 185,187,144 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 37,037,428 股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日起至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过 196,954.40 万元。国家集成电路基金、杭州溯智、杨云春认购本次非公开发行股票的认购金额及认购的股票数量由公司董事会或董事会授权人士与发行对象协商确定。

（二）调整后

本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过 160,000 万元，其中，国家集成电路基金认购金额不超过人民币 140,000 万元、杨云春认购金额不超过 20,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格及发行数量将作相应调整。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。截至第二届董事会第三十八次会议召开之日，上市公司总股本为 185,187,144 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 37,037,428 股（含本数）。

在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日起至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会

根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

根据证监会出具的《关于核准北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]146号），本次非公开发行股票数量不超过 37,037,428 股新股。2018 年 5 月 31 日，公司发布了《北京耐威科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2018 年 6 月 6 日，除权除息日为 2018 年 6 月 7 日。目前公司 2017 年度权益分派方案已实施完毕，本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 37,037,428 股（含本数）相应调整为不超过 55,556,142 股（含本数）。

若本次非公开发行的股票数量因监管要求或股价波动而产生变化，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化，但最高不超过 160,000 万元。国家集成电路基金、杨云春认购本次非公开发行股票的认购金额及认购的股票数量由公司董事会或董事会授权人士与发行对象协商确定。

三、募集资金

（一）调整前

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 196,954.40 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	259,752.00	140,000.00
2	航空电子产品研发及产业化项目	61,582.00	56,954.40
合计		321,334.00	196,954.40

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（二）调整后

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 160,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	259,752.00	140,000.00
2	航空电子产品研发及产业化项目	61,582.00	20,000.00
合计		321,334.00	160,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，本次非公开发行股票预案的其他内容不变。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日